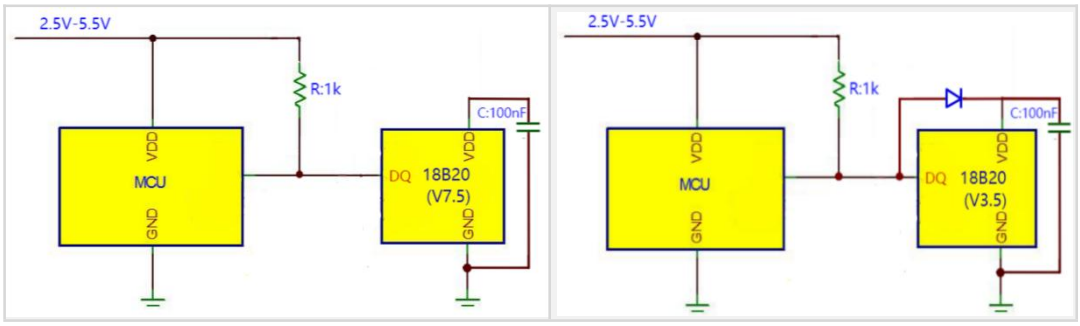
MY18B20Z V3.5升级V7.5工程变更通知书

尊敬的客户：

您好！

我司数字温度芯片MY18B20Z推出了升级迭代版本V7.5，寄生模式电路配置更加精简，只用一个储能电容即可（可省掉一个二极管），参见下述应用电路图。另外，温度精度、一致性等性能也都有所提高。



V7.5/V3.5寄生模式应用电路图

MY18B20ZD30（V3.5）升级后对应型号为MY18B20ZD10(V7.5)，测温精度区间有细微提升，详见下表。

MY18B20Z版本型号及性能对比表

产品型号	MY18B20ZD10-15 /MY18B20ZD10	MY18B20ZD30-15 /MY18B20ZD30
硬件版本	V7.5	V3.5
典型测温精度	±1℃@0°C~+70°C ±3℃@-55°C~+125°C	±1℃@0°C~+60°C ±3℃@-55°C~+125°C
测温速度	15ms/500ms	15ms/500ms

如上所述，新版本V7.5可进一步节约客户寄生模式应用成本、提高精度及一致性，推荐用户逐步替换。我司将全力支持您进行产品升级替代工作，遇到任何问题请和我们沟通，感谢您的支持与配合！

浙江敏源传感科技有限公司

2025年5月6日